

# When plasma matters



**Trymax®**

PLASMA TECHNOLOGY SOLUTIONS

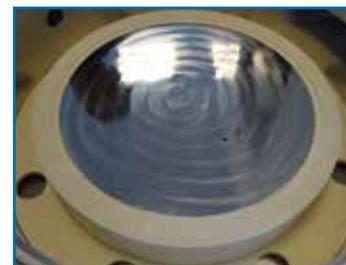
**NEO 300**



PLASMA TECHNOLOGY SOLUTIONS

# NEO 300

Установка плазменной обработки NEO 300 от компании Trymax Semi Conductor является современной системой удаления фоторезиста, травления, озонения и зачистки пластин. Система специально предназначена для обработки подложек диаметром до 300 мм. Она оснащена полуавтоматической станцией загрузки, которая способна обрабатывать подложки размером до 300 мм. Линейка NEO 300 отвечает всем требованиям исследовательских институтов и производителей устройств, имеет компактный размер, что позволяет максимально снизить эксплуатационные расходы.



#### • Характеристики

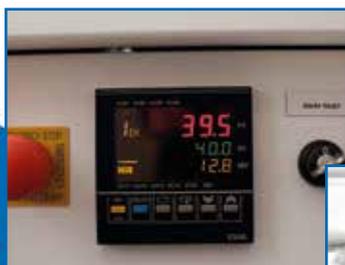
- Размер п/п пластин/подложек до 300 мм
- Загрузочная платформа для полуавтоматического переноса п/п пластин
- 4 технологических модуля:
  - СВЧ (2,45 ГГц)
  - ВЧ-смещение (13,56 МГц)
  - Двойной источник (СВЧ, ВЧ-смещение)
  - DCP (ВЧ-смещение, плазма постоянного тока)
- Высокая равномерность и воспроизводимость
- Компактное основание
- Низкие эксплуатационные расходы
- Система связи с цифровым управлением (Devicenet-Ethernet)
- Промышленный ПК на базе Windows

#### • Применение

- Удаление резиста с большой площади
- Удаление непроявленного резиста
- Удаление полимера
- Удаление резиста после высокодозной ионной имплантации
- Травление нитрида кремния
- МЭМС
- Корпусирование и тестирование (PR, PI, BCB, PBO)

#### • Стандарты соответствия

- SEMI S2-01
- SEMI S8-01
- CE
- EU-RoHs



Официальный представитель в России



«ТБС», Москва, Киевская 7

Telephone: +7 (495) 287 8577  
+7 (495) 783 0284

E-mail: info@tbs-semi.ru  
Web: www.tbs-semi.ru

[www.trymax-semiconductor.com](http://www.trymax-semiconductor.com)